

## GY-HM01

### 厚膜金导体浆料

#### 产品介绍

GY-HM01是一款不含铅、镉，适合丝网印刷的金导体浆料，用作高密度混合电路中的金线键合。GY-HM01适合1-mil和2-mil金丝的自动键合。

#### 产品特点

用于杜邦 QM42、5704 多层介质材料上具有良好的兼容性。

#### 典型性能

性能	指标
粘度 <sup>1</sup> (Pa.s, 5 rpm, 25°C)	200 - 300
印刷面积 (cm <sup>2</sup> /gram)	50 - 80
分辨率 (um, dried)	100/ 100
烧结膜厚 (um)	6 -9
方阻 (mΩ/sq)	≤ 7@9um 烧结厚度
<sup>1</sup> Brookfield HBD 52Zcone	

#### 推荐工艺

**基板:** GY-HM01性能是基于 96%氧化铝基板的测试。其他成分的基板和不同制造商的基板可能会导致性能属性的变化。

**印刷:** 推荐使用 325 目不锈钢丝网，乳胶厚度 15 μm。印刷速度可达 15 厘米/秒。印刷应该在清洁通风的环境中经行，在 20-23°C环境中印刷浆料具有最佳的印刷性能。

**干燥:** 浆料印刷后，在室温下流平 5-10 分钟，然后在通风的烘箱或传送带式干燥炉中150°C干燥10-15分钟。

**烧结:** 烧结在具有通气的链式烧结炉中进行，使用 60 分钟周期烧结曲线，峰值温度850 °C，10 分钟。850°C多次重烧性能没有明显变化。

**存储和有效期:** 浆料应在密闭的容器中清洁、温度稳定的环境中保存，温度小于25°C。在没有打开容器的情况下，保质期为发货日期6个月。长时间存放可能会发生固体物沉降，使用前进行充分搅拌。

**安全与处理:** 本产品含有有机溶剂和材料，在使用GY-HM01时应采取以下预防措施：

在有足够通风的情况下使用；

避免长时间接触皮肤避免长时间吸入蒸汽；

如接触皮肤，应立即用肥皂和水清洗患处；

吞食有危险；